GRANDS-GAPS

Matériaux Grands Gaps pour l'Electronique de Puissance: Enjeux, intégration système & commande rapprochée

> 5 jours en résidentiel: du 18/06/2018 au 22/06/2018



https://grandsgaps2018.sciencesconf.org









GRANDS-GAPS

Pourquoi?

Matériaux Grands Gaps pour l'Electronique de Puissance: Enjeux, intégration système & commande rapprochée

La gestion de l'énergie électrique est au cœur des priorités nationales, européennes et internationales. Pour exemple, la commission européenne a identifié l'enjeu énergétique comme hautement prioritaire, via le défi sociétal « <u>Secure, Clean and Efficient Energy</u> » du programme H2020. Les convertisseurs d'énergie électrique font partie des outils qui permettront de répondre à ces défis techniques, en repoussant les compromis classiques de rendement énergétique, fiabilité et intégration.

Parmi les ruptures technologiques de premier plan, l'émergence des composants de puissance à matériaux grands-gaps (SiC, GaN) et ultra grands-gaps (Ga₂O₃, AlN, diamant) impose de reconsidérer l'association entre les transistors de puissance et les circuits de commande rapprochée, sous les contraintes d'augmentation des vitesses de commutation, de fréquence de commutation, de températures limites de fonctionnement et de tensions à supporter. Les ruptures sur les transistors de puissance à matériau grand-gap doivent être couplées à une optimisation système, en lien avec les applications et les contraintes technologiques. Cette nouvelle donne impose une approche pluridisciplinaire, mariant l'électronique de puissance et les technologies de la microélectronique, en focalisant particulièrement l'attention des acteurs du domaine sur les interactions entre circuits de pilotage rapproché (« gate driver ») et cellules de commutation de puissance à transistors grands-gaps.







GRANDS-GAPS

Matériaux Grands Gaps pour l'Electronique de Puissance: Enjeux, intégration système & commande rapprochée

Les composants grands gaps pour l'électronique de puissance:

- Changement récent,
- Repousse les contraintes,
- Multi-disciplinaire,
- Multi-échelle





Augmentation densité de puissance

&/ou

Augmentation du rendement





Material

Thick Drift Low doping Conductive substrates Defects

Device

Vth control inversion Highest Ecrit - JTE

DC and dV/dt immunities

Circuit and system

High Temp - High Jon
dV/dt, dI/dt, HVoltage -Low
Rseries
EMC, Gate driver, Integration



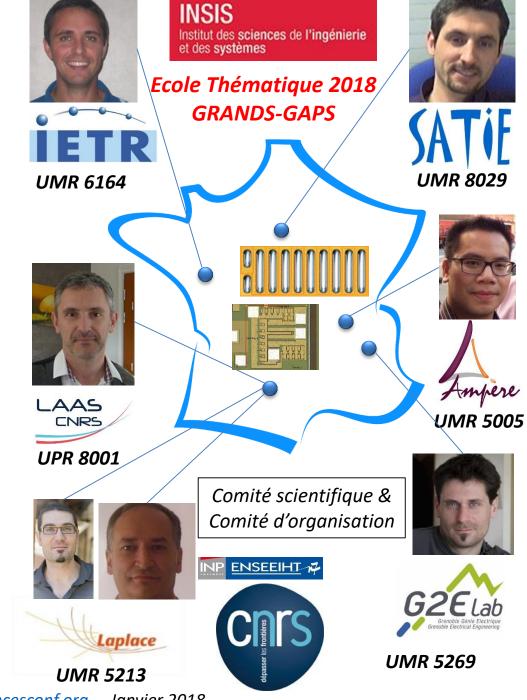




GRANDS-GAPS

Matériaux Grands Gaps pour l'Electronique de Puissance: Enjeux, intégration système & commande rapprochée

> 7 organisateurs + 6 intervenants









GRANDS-GAPS

Programme prévisionnel

LAPLACE

Matériaux Grands Gaps pour l'Electronique de Puissance:

Enjeux, intégration systèm?

Lundi 18/06/2018 Accueil à Toulouse, café et Gate Driver I - Etait de l'art des Gate Driver III - L'intégration des drivers industriels: analyse fonctions de composants grands gaps dans visite plateforme 3DPHI site N7 10:15 - 10:30 Départ et transfert en car vers MAS Gate Driver III - L'intégration de BE II - Conception gate driver structurelle des principales fonctions de composants grands gaps composants grands gaps (Schematics, hands on) (+ exemples de gate Intégration I - problématiques de Composants grands gaps and gaps). Critères outage puissance/commande, de SABOTH (arrivée 12h30) 12:00 - 13:15 Repas Rep							
O8:15- 10:15 présentation de l'Ecole Thématique. Visite plateforme 3DPHI site N7 10:15- 10:30 Départ et transfert en car vers MAS drivers (Si vs. grands gaps), critères routage puissance/commande, de SABOTH (arrivée 12h30) de SABOTH (arrivée 12h30) de Choix et dimensionnement technologies d'intégration et CEM technologies d'intégration et CEM Repas Repas Repas Repas Ateliers doctoraux: le convertisseur ode de demain - session poster et 13:15-15:15 matériaux (Si vs. SiC, GaN, Diamant), architectures de composants 15:30-17:30 Nouveaux composants grands gaps: composants grands gaps Conclusion de l'Ecole Thématique et retour en car sur Toulouse (départ orbits de demain - session poster et de demain - session poster et drivers (Si vs. grands gaps) Conclusion de l'Ecole Thématique et Intégration II - intégration II - intégration de l'Ecole Thématique et retour en car sur Toulouse (départ orbits de composants grands gaps Composants grands gaps Coffee break Système II - Dimensionnement et dynamiques pour les composants grands gaps Coffee break Système II - L'électronique Haute Température: contraintes sur la puce Retour sur Toulouse à 16h30 Repas Repas Conclusion de l'Ecole Thématique et Intégration II - intégration II - intégration de retour en car sur Toulouse à 16h30 Retour sur Toulouse à 16h30		Lundi 18/06/2018	Mardi 19/06/2018	Mercredi 20/06/2018	Jeudi 21/06/2018	Vendredi 22/06/2018	
Départ et transfert en car vers MAS de Driver II - exemples de gate Intégration I - problématiques de drivers (Si vs. grands gaps), critères routage puissance/commande, de SABOTH (arrivée 12h30) 12:00 - 13:15 Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas Nouveaux composants grands gaps: architectures de composants 13:15 - 15:30 Coffee break Etat de l'art, challenge II - Nouveaux composants grands gaps: de demain - session poster et Coffee break Système II - Mesures statiques et dynamiques pour les composants Température: contraintes sur la puce interactions commande-puissance échanges en plein air (selon météo) grands gaps et le packaging 17:30 - 18:00 Round table: bilan de la journée Round table: bilan de la journée			drivers industriels: analyse	fonctions de communication dans		BE II - Conception gate driver	
Départ et transfert en car vers MAS Gate Driver II - exemples de gate drivers (Si vs. grands gaps), critères routage puissance/commande, de SABOTH (arrivée 12h30) de choix et dimensionnement technologies d'intégration et CEM rechnologies d'intégration et CEM cellules de commutation layout) 12:00 - 13:15 Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas Système I - Dimensionnement et Intégration II - intégration de l'Ecole Thématique et 13:15 - 15:15 natériaux (Si vs. SiC, GaN, Diamant), architectures de composants 15:15 - 15:30 Coffee break Etat de l'art, challenge II - Etat de l'art, challenge II - Nouveaux composants grands gaps: de demain - session poster et de demain - session poster et Composants grands gaps composants passifs Coffee break Système II - L'électronique Haute dynamiques pour les composants rempérature: contraintes sur la puce Retour sur Toulouse à 16h30 Retour sur Toulouse à 16h30 Retour sur Toulouse à 16h30		Visite plateforme 3DPHI site N7	et schématique associée	composants grands gaps			
de SABOTH (arrivée 12h30) de choix et dimensionnement 12:00 - 13:15 Repas Conclusion de l'Ecole Thématique et de demain - intégration in de l'Ecole Thématique et demain - session poster et demain - ses	10:15 - 10:30		Coffee break	Coffee break		(schematics, hands on) (+ exemples	
12:00 - 13:15 Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas Conclusion de l'Ecole Thématique et Système I - Dimensionnement et Intégration II - intégration de l'Ecole Thématique et Système I - Dimensionnement et Intégration II - intégration de l'Ecole Thématique et Conclusion de l'Ecole Thématique et Système I - Dimensionnement et Intégration II - intégration de l'Ecole Thématique et Système II - Intégration II - intégration II - intégration II - intégration de l'Ecole Thématique et Conclusion de l'Ecole Thématique et Système II - Intégration II - intég	10:30 - 12:00						
Etat de l'art, challenge I - Ateliers doctoraux : le convertisseur Nouveaux composants grands gaps: matériaux (Si vs. SiC, GaN, Diamant), architectures de composants 15:15 - 15:30 Coffee break Etat de l'art, challenge II - Ateliers doctoraux : le convertisseur Composants grands gaps Composants grands gaps Composants grands gaps Composants passifs Coffee break Coffee break Système II - Mesures statiques et dynamiques pour les composants Température: contraintes sur la puce Retour sur Toulouse à 16h30 Round table: bilan de la journée		de SABOTH (arrivée 12h30)	de choix et dimensionnement	technologies d'intégration et CEM	cellules de commutation	layout)	
Nouveaux composants grands gaps: matériaux (Si vs. SiC, GaN, Diamant), architectures de composants 15:15 - 15:30 Coffee break 15:15 - 17:30 Nouveaux composants grands gaps: interactions commande-puissance 17:30 - 18:00 Round table: bilan de la journée Nouveaux composants grands gaps: choix d'une topologie et des retour en car sur Toulouse (départ composants grands gaps Coffee break Coffee break Coffee break Système III - L'électronique Haute dynamiques pour les composants Température: contraintes sur la puce interactions commande-puissance échanges en plein air (selon météo) grands gaps et le packaging Round table: bilan de la journée Round table: bilan de la journée	12:00 - 13:15	Repas	Repas	Repas	Repas	Conclusion de l'Ecole Thématique et	
Système II - Mesures statiques et Système III - L'électronique Haute 15:30 - 17:30 Nouveaux composants grands gaps: interactions commande-puissance échanges en plein air (selon météo) grands gaps et le packaging 17:30 - 18:00 Round table: bilan de la journée Round table: bilan de la journée Round table: bilan de la journée Système III - L'électronique Haute Retour sur Toulouse à 16h30 Retour sur Toulouse à 16h30	13:15 - 15:15	Nouveaux composants grands gaps: matériaux (Si vs. SiC, GaN, Diamant),		choix d'une topologie et des			
15:30 - 17:30 Nouveaux composants grands gaps: interactions commande-puissance échanges en plein air (selon météo) grands gaps et le packaging 17:30 - 18:00 Round table: bilan de la journée Retour sur Toulouse à 16h30 Retour sur Toulouse à 16h30 grands gaps et le packaging Round table: bilan de la journée Round table: bilan de la journée	15:15 - 15:30	Coffee break	de demain - session poster et	Coffee break	Coffee break	14h30)	
17:30 - 18:00 Round table: bilan de la journée						Retour sur Toulouse à 16h30	
		interactions commande-puissance	échanges en plein air (selon météo)	grands gaps	et le packaging		
ANIMATION: dégustation des	17:30 - 18:00	Round table: bilan de la journée	Round table: bilan de la journée	Round table: bilan de la journée	Round table: bilan de la journée		
Diner Break et interactions libres produits du terroir Diner Break et interactions libres							
v. 18/01/20							v. 18/01/2018





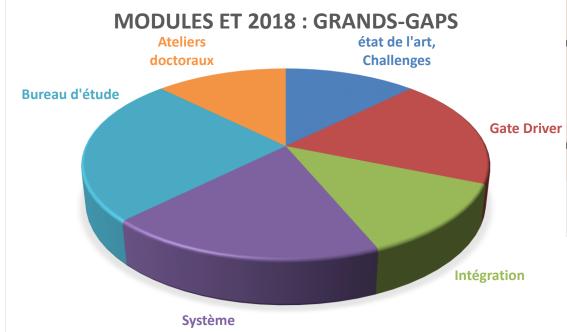
G2Elab



LAAS

ECOLE THEMATIQUE CNRS 2018 GRANDS-GAPS

Matériaux Grands Gaps pour l'Electronique de Puissance: • Enjeux, intégration système & commande rapprochée



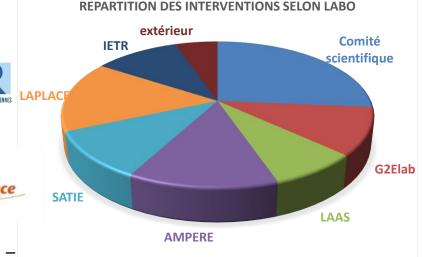
Modules de la formation:

- Etat de l'art, challenge I & II (4h)
- Gate Driver I, II & II (6h)
- Intégration I, II (4h)
- **Système** I, II & III (6h)
- Bureau d'étude | & || (8h)

Simulations & démonstrations expérimentales

Ateliers doctoraux (4h) & échanges











AAS

CNRS









Pension complète:

Petit déjeuners, déjeuners et dîners inclus (repas à l'assiette) Pauses cafés incluses











1 Chambre et SdB par Personne

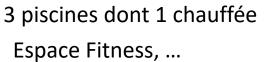
Chaque Bungalow comprend 2 chambres





Nombreux espaces détente & de convivialité











Beach volley











ECOLE THEMATIQUE CNRS 2018 GRANDS-GAPS

Matériaux Grands Gaps pour l'Electronique de Puissance: Enjeux, intégration système & commande rapprochée

Calendrier

- Janvier 2018: ouverture des inscriptions
- Mars 2018: Consolidation nb participant.e.s
- 18 au 22 Juin 2018: Ecole thématique



Ecole + car + hébergement 5j

- + 9 repas + cafés + supports
- + organisation, matériel
- + missions intervenants

- CNRS: **0€** (limité à 10 places)
- Doct. : 200€ (ch simple)
- Perm. Univ.: 380€ (ch simple)
- Autres: 800€
- Accompagnant: **350€**







GRANDS-GAPS

Matériaux Grands Gaps pour l'Electronique de Puissance: Enjeux, intégration système & commande rapprochée

Nos sponsors au 18 Janvier 2017





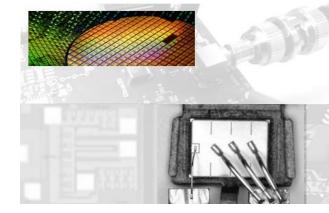












Ecole Thématique 2018 GRANDS-GAPS

Matériaux Grands Gaps pour l'Electronique de Puissance : Enjeux - Intégration Système - Gate Driver



18 au 22 juin 2018

Une opportunité unique de formation et d'échanges, avec un format résidentiel propice aux échanges

Inscrivez-vous!



https://grandsgaps2018.sciencesconf.org





